

产品规格书

SPECIFICATION

客 户

Customer

产品类型

Device

点阵

产品型号

Model

SLD0888FR1C1BD-3.5D

产品编号

NO.

DS2401036

日 期

Date

2024-01-19

顾 客 确 认



SUNLIGHT

东莞市光华电子有限公司

Dongguan Sunlight Electronic CO., LTD

地址：广东省东莞市东城区下桥工业园 U 幢

电话：(0769) 22202947

传真：(0769) 22208815

研究开发中心

批 准

审 核

制 定

袁召爱

丘益鹏

陈土贵

一、特点：

- $\Phi 1.9\text{mm}$ 8*8 点阵
- 红色发光，功耗低、寿命长
- 黑面白胶，共阴显示
- 符合欧盟公布 RoHS 指令

二、用途：

广泛应用于各类家用电器、仪器、仪表等产品中

三、极限参数 ($T_A=25^\circ\text{C}$)：

参数名称	符号	数值	单位
正向电流	I_F	20	mA
反向电压	V_R	5	V
工作温度	T_{OPR}	$-20 \sim +75$	$^\circ\text{C}$
储存温度	T_{stg}	$-25 \sim +85$	$^\circ\text{C}$
正向脉冲电流	I_{FP}	60	mA

* 注：脉冲宽度 $\leq 0.1\text{ms}$ ，占空比 $\leq 1/10$

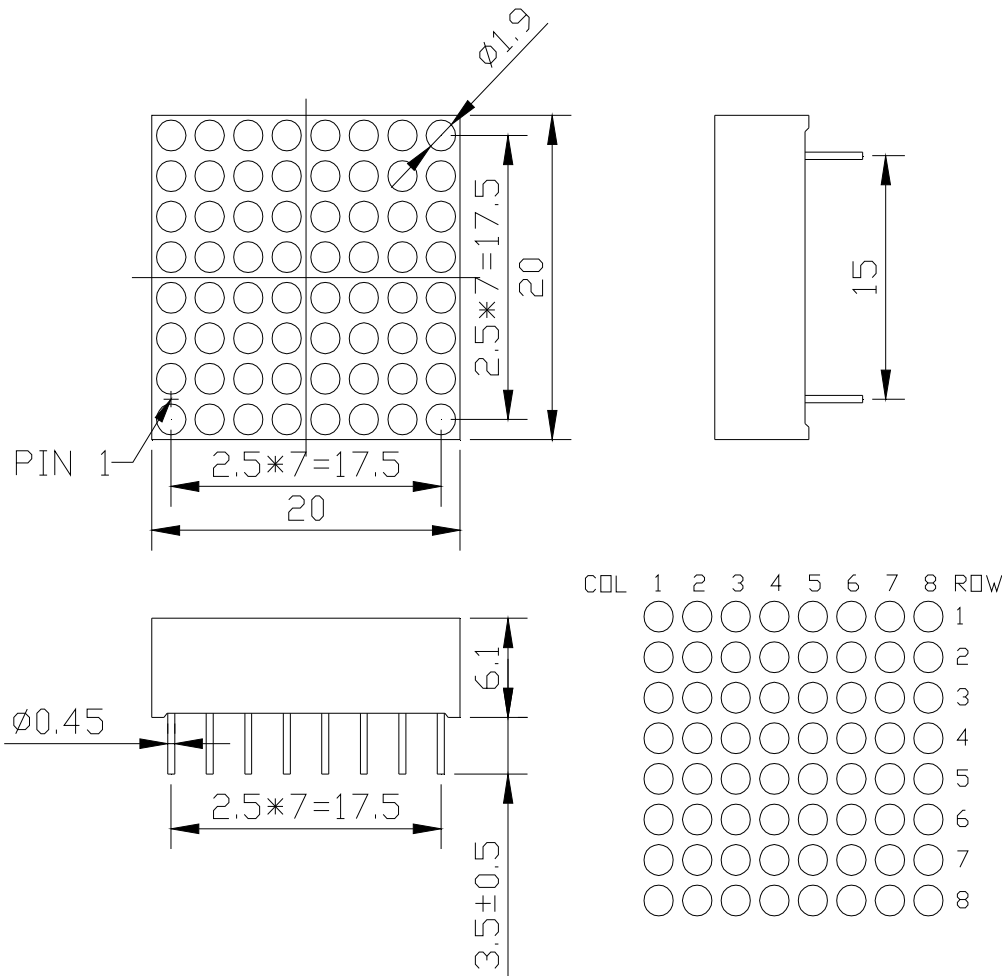
四、光电参数 ($T_A=25^\circ\text{C}$)：

参数名称	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
正向电压	V_F	$I_F=20\text{mA}$	1.7	2.0	2.4	V
反向电流	I_R	$V_R=5\text{V}$	---	---	50	μA
峰值波长	λ_p	$I_F=20\text{mA}$	---	622	---	nm
主波长	λ_d	$I_F=20\text{mA}$	618	---	630	nm
半波宽度	$\Delta\lambda$	$I_F=20\text{mA}$	---	20	---	nm
发光强度	I_v	$I_F=20\text{mA}$	100	---	200	mcd

东莞市光华电子有限公司

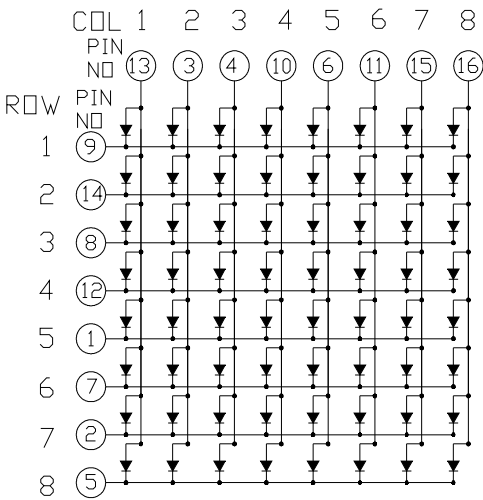
Tel: 0769-2767395 22202947 Fax: 22208815

五、 外形尺寸：



其余公差：±0.25
单 位： mm

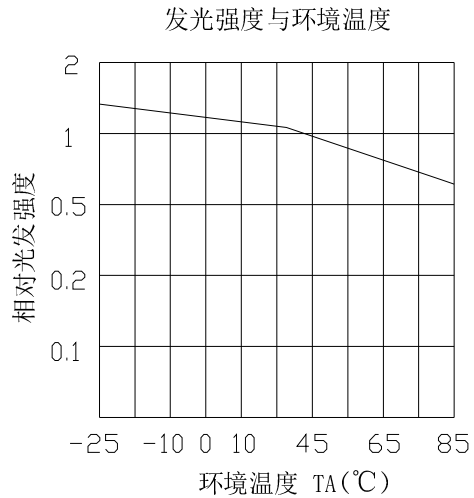
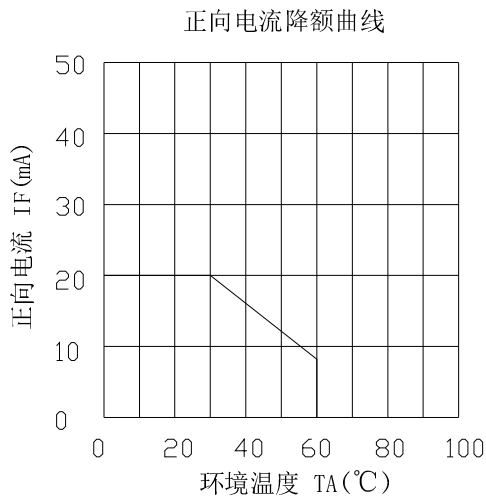
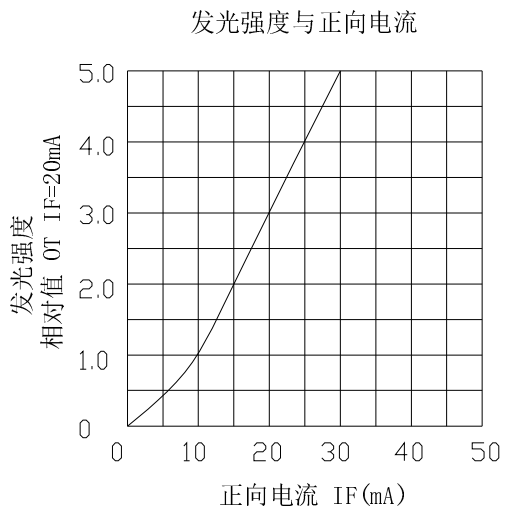
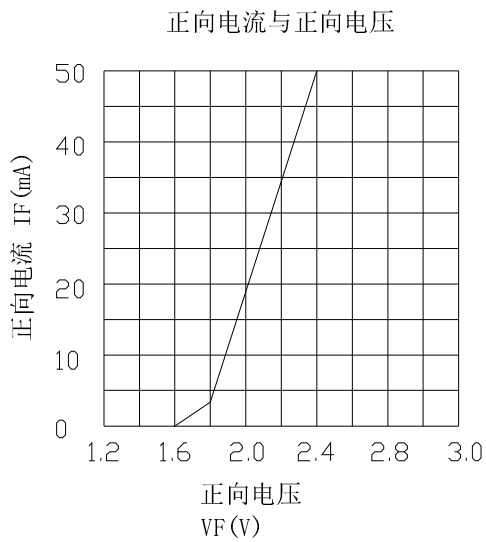
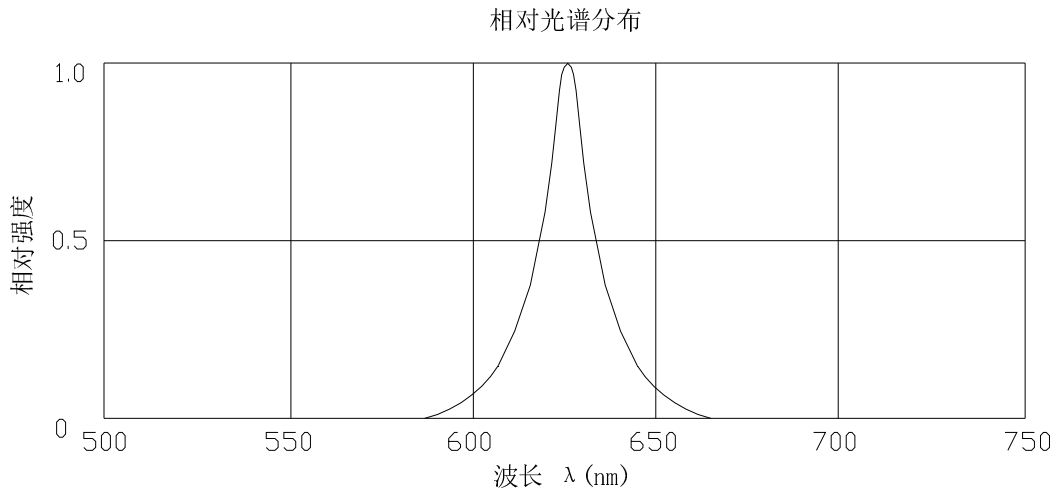
六、 线路图：



东莞市光华电子有限公司

Tel: 0769-2767395 22202947 Fax: 22208815

七、特性曲线：



东莞市光华电子有限公司

Tel: 0769-2767395 22202947 Fax: 22208815

八、使用注意事项：

1、储存：

在温度低于 30°C，湿度不高于 60%RH 的条件下，不良的储存条件会导致产品引脚的腐蚀或产品性能的改变。

2、静电：

静电和电涌会导致产品特性发生改变，例如正向电压降低等，如果情况严重甚至会损毁产品，所以在使用时必须采取有效的防静电措施。所有相关的设备和机器都应该正确的接地，同时必须采取其他防静电和电涌的措施。使用防静电手环，防静电垫子，防静电工作服，工作鞋，手套，防静电容器，都是有效的防止静电和电涌的措施。

3、设计建议：

设计电路时，通过 LED 的电流不能超过规定的最大值，同时还需要使用保护电阻，否则微小的电压变化将会引起较大的电流变化，可能导致产品损毁。

LED 的特性容易因为自身的发热和环境的温度的改变而发生改变。温度的升高会降低 LED 的发光效率，影响发光颜色等，所以在设计时应充分考虑散热的问题。

4、焊接：

焊接过程中的不慎操作将会引起产品的损坏，请务必注意。焊接过程中应避免对产品引脚或封装部分施加压力。焊接时，请保证焊接位置与封装树脂底部有一定的距离，该距离因不同的焊接方法而有所不同，请参照以下推荐焊接条件。

推荐焊接条件：

波峰焊接		烙铁焊接	
预热	100°CMax. 60sec. Max	焊接温度	300°C Max
温度	260°CMax. 5sec. Max	焊接时间	3sec. Max
焊接位置	2mm ,Min 与树脂底部的距离	焊接位置	2mm ,Min 与树脂底部的距离

. 不管采用何种焊接方法，焊接只能进行一次。

. 焊接完成后，在LED 温度下降到室温之前，请不要对产品施加压力。